

◆ 陽極接合装置 ◆

型式： HORIVAC400AT



—製品概要—

本装置はSiウエハーとPXガラスを接合する装置です

—特徴—

- ▶ 当社独自のカーボンヒータを使用
- ▶ 高温に加熱して独自開発の印加ピンに直流負極電圧(可変電圧印加)を順次3セクションに分けて印加し、基板同士の密着接合をします
- ▶ 特に微細加工した後の基板を接合することによって、圧力センサ等の一枚の基板だけでは実現できない複雑なデバイスを作り上げることが可能です
- ▶ 最近はMEMS/化合物半導体の研究用・生産用として注目を集めています

—応用—

- 圧力センサ
- 加速度センサ
- 各種マイクロセンサ
- 次世代半導体デバイス



—標準仕様—

操作方法・・・手動/自動
加熱温度・・・MAX600
処理能力・・・150(6吋ウエハー)×1枚
槽寸法・・・310×H410
温度制御方式・・・PID方式
電力・・・3相 20KVA 200V 120A
排気系・・・ターボ分子ポンプ・油回転ポンプ
使用圧力範囲・・・ 10^{-4} Pa